

MiTAC Computing Technology Corporation

30.05.2022 – 14:01 Uhr

TYAN präsentiert auf der ISC 2022 optimierte HPC-Plattformen zur Beschleunigung rechenintensiver Anwendungen

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -

TYAN®, ein branchenführender Hersteller von Serverplattformen und Tochterunternehmen der MiTAC Computing Technology Corporation, stellt seine neuesten Serverplattformen mit [Intel® Xeon® Scalable Prozessoren der 3. Generation](#), die für HPC- und KI-Märkte optimiert sind, auf der ISC 2022 vom 3. Mai bis 1. Juni an Stand #D400 in Hamburg vor.

„Das Wachstum des HPC-Marktes wird stark von neuen Technologien und der zunehmenden Anwendung von Big-Data-Analysen angetrieben. Dadurch entsteht ein Bedarf an einer besseren Computerinfrastruktur zur Verarbeitung großer Datenmengen, die auf dem Markt verfügbar sind“, sagte Danny Hsu, Vice President der Server Infrastructure Business Unit der MiTAC Computing Technology Corporation. „Die HPC-Serverplattformen von TYAN basieren auf Intel Xeon Scalable Prozessoren der 3. Generation, die Unternehmen und Organisationen dabei helfen, die Entwicklung der nächsten Generation von HPC- und KI-Systemarchitekturen zu beschleunigen.“

Hochmoderne HPC-Systeme, die für die Beschleunigung rechenintensiver Arbeitslasten und HPC-Implementierungen optimiert sind

TYANs [Thunder HX FT83A-B7129](#) ist ein 4U-Supercomputer mit zwei Sockeln, der bis zu zehn Hochleistungs-GPU-Karten unterstützt. Mit zwei Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 3. Generation und 32 DDR4-DIMM-Steckplätzen bietet die FT83A-B7129-Plattform eine herausragende heterogene Rechenleistung für eine Vielzahl von GPU-basierten wissenschaftlichen Hochleistungsrechnern, KI-Training, Inferenzen und Deep-Learning-Anwendungen. Das System bietet zwölf werkzeuglose 3,5-Zoll-Laufwerksschächte mit bis zu vier U.2-NVMe-Geräten.

Der [Thunder HX FT65T-B5642](#) ist ein 4U-Single-Socket-Sockel-Server, der für kleinere HPC-Workloads entwickelt wurde, die eine hohe Rechenleistung auf dem Schreibtisch benötigen. Das System verfügt über einen einzelnen Intel Xeon Scalable-Prozessor der 3. Generation, acht DDR4-3200-DIMM-Steckplätze, acht 3,5-Zoll-SATA- und zwei werkzeuglose NVMe-U.2-Hot-Swap-Laufwerksschächte. Der FT65T-B5642 unterstützt zwei doppelt breite PCIe 4.0 x16-Steckplätze für GPUs zur Beschleunigung von HPC-Anwendungen.

Der [Thunder SX TS65-B7126](#) ist ein 2U-Dual-Socket-Hybrid-Speicherserver, der für softwaredefinierte Speicheranwendungen entwickelt wurde. Das System verfügt über 16 DDR4-3200-DIMM-Steckplätze, zwölf werkzeuglose 3,5-Zoll-SATA-Hot-Swap-Laufwerkseinschübe mit Unterstützung für bis zu vier NVMe-U.2-Geräte und zwei rückwärtige werkzeuglose 2,5-Zoll-Hot-Swap-SATA-Laufwerkseinschübe für den Einsatz von Boot-Laufwerken.

Das [Tempest HX S7120](#) ist ein Mainstream-Server-Motherboard im SSI EEB-Formfaktor (12" x 13,1"), das für HPC-Anwendungen entwickelt wurde. Das Standard-Motherboard unterstützt zwei Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 3. Generation, 16 DDR4-3200-DIMM-Steckplätze, zwei 10GbE- oder GbE-Onboard-Netzwerkanschlüsse, drei PCIe 4.0 x16- und zwei NVMe M.2-Steckplätze.

TYANs [Tempest CX S5560](#) ist ein Server-Motherboard im Micro-ATX-Formfaktor, das einen einzelnen Intel® Xeon® E-2300 Prozessor, vier DDR4-3200 DIMM-Steckplätze, drei PCIe-Steckplätze, bis zu acht SATA 6G-Anschlüsse, zwei NVMe M.2-Steckplätze und zwei 10GbE Onboard-LAN-Anschlüsse unterstützt. Das Motherboard ist ideal für Multi-Access-Edge-Computing-Server in 5G-Netzwerken und Service-Access-Server in einer CSP-Umgebung.

Besuchen Sie den TYAN-Stand auf der ISC 2022, Stand#D400 oder ISC Digital 2022 unter <https://bit.ly/3FhIAYO>

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1824540/TYAN_s_HPC_Server_Platforms_are_based_on_3rd_Gen_Intel_Xeon_Scalable_Processors_-_to_Accelerate_HPC_D.jpg

Pressekontakt:

Ferry Chen,
fenny.chen@mic.com.tw

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100090544/100889930> abgerufen werden.